

扬州扬杰电子科技股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为积极践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以维护全体股东利益、增强投资者信心、促进公司高质量发展为目标，围绕公司核心竞争力，结合发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案（以下简称“行动方案”），具体内容详见公司于2024年2月5日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份进展暨“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-004）。

2026年上半年，公司在专注主业发展、深耕功率半导体，坚持创新驱动、加速国产化进程，完善公司治理、强化规范运作，提升信息披露质效、加强价值传递和以投资者为本、落实股东回报等方面采取措施，切实推动“质量回报双提升”，现针对行动方案相关举措在2026年半年度的进展说明如下：

一、专注主业发展，深耕功率半导体

公司专注功率半导体主业发展，紧抓全球能源转型与智能化升级机遇，聚焦AI数据中心、新能源汽车、光储充、工业、消费类电子等领域，为客户提供一站式产品、技术、服务解决方案，实现了行业TOP大客户全覆盖。

报告期内，在AI算力需求带动功率器件需求激增、人形机器人等新兴应用场景加速落地的背景下，功率半导体行业呈现车规级、AI算力等多赛道共振的结构性高景气态势。公司紧抓市场机遇，持续加大MOSFET、IGBT、SiC等产品的推广力度，整体订单和出货量保持较快增长，营业收入同比增长30.69%。其中，新能源汽车业务板块，公司聚焦高压化、功率密度与效率提升、可靠性需

求增强等行业趋势，持续加大高电压、大功率器件的研发投入。公司已取得多家国际标杆汽车整车厂和 Tier1 客户认证，技术方案和产品性能获得多家主流客户认可。该业务板块延续良好发展态势，收入同比增长超 100%。AI 数据中心业务板块，公司新设 AI 事业部，围绕客户新一代 AI 数据中心电源产品，开展器件选型、样品测试、方案适配和可靠性验证，多款产品持续推进客户认证和样品导入，该业务板块营收同比增长近翻倍。SiC 业务板块，受益于新产品持续推出、客户端导入进程加快以及产能稳步释放，收入同比增长近翻倍。

依托综合营收规模、技术研发实力及市场占有率等核心指标，公司多次蝉联由中国半导体行业协会评选的“中国半导体功率器件十强企业”前三强，OMDIA 全球功率半导体 discrete 榜单排名第八，位列国内外多个半导体企业榜单中前二十强、工信部汽车白名单等，斩获全国首张芯片国产化权威认证、中国 SiC 器件 IDM 十强企业等行业荣誉。报告期内，公司 1200V SiC MOSFET 产品斩获 CSPSD 2026 优秀技术创新产品奖，行业影响力与品牌认可度持续提升。

二、坚持创新驱动，加速国产化进程

创新是第一生产力，也是公司持续发展的不竭动力。公司在扬州总部设有中央研究院，负责前沿技术研发、基础研发及实验室建设运营，并统筹管理研发项目。各事业部和产品线设有研发部门（包括 GaN、SiC、IGBT、MOSFET、low Cj ESD 保护器件等研发团队），围绕市场需求及行业趋势进行产品研发和量产导入，形成“预研一代、开发一代、量产一代”的产品开发管理体系。

报告期内，依托持续的研发投入、先进的研发平台及高素质人才队伍，公司围绕 MOSFET、SiC、IGBT 等全系列产品，面向 AI 数据中心、新能源汽车、光储充、工业、消费类电子等下游应用领域，顺应市场发展趋势与客户实际需求，针对行业对相关核心指标不断提升的要求，持续开展性能优化，加速技术平台迭代，持续推进新产品开发，实现多系列新品落地。目前公司已形成多电压平台协同推进、车规认证持续落地、核心性能指标领先市场的技术驱动型成长路径。

秉持“人才是创新的根基与源泉”的理念，公司积极深化与知名院校及科研院所的产学研合作。报告期内，公司与扬州大学共同组建的“扬州大学-扬杰科技 GaN 功率器件联合研发中心”，专注于汽车和 AI 数据中心应用相关的 GaN

HEMT 器件研发及产业化发展，经过多年的持续努力，取得丰硕成果，用于 AI 数据中心的新一代 GaN HEMT 产品研发成功，经可靠性试验显示，产品性能对标行业标杆，稳定性对标国际水平，即将上市。同时持续引进国内外资深技术人才，形成了一支覆盖高端芯片研发设计、先进功率半导体晶圆制造、先进封装研发设计等各方面的高质量人才队伍，其中包括工信部科技创新领军人才、工信部制造业先进基础工艺人才、省部级“双创计划”创新创业领军人才、江苏省 333 人才和江苏省六大高峰人才等。

报告期内，公司研发费用率为 6.01%。截至报告期末，公司累计获授知识产权 741 件，其中国内发明专利 148 件，实用新型 499 件，集成电路布图设计 71 件，软件著作权 9 件，外观设计 14 件。作为功率半导体领域标准的主要起草单位之一，参与了国标《半导体分立器件第 1 部分：分规范》（计划号：20233151-T-339）、《半导体分立器件第 2 部分：分立器件整流二极管》（计划号：20232773-T-339）、《碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管(SiC MOSFET)阈值电压测量指南》（计划号：20263331-T-339）、GB/T4973《半导体器件机械和气候试验方法第 6 部分：高温贮存》及团标《半导体芯片封装用导电胶性能要求及测试方法》《光伏组件接线盒用模块二极管》《半导体封装用 UV 减黏保护膜性能要求及测试方法》的编制与修订。

三、完善公司治理，强化规范运作

公司严格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等制度要求，已建立、健全法人治理结构并规范运作，具备完善的股东会、董事会和管理层独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互制约，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等要求，董事会成员包含会计专业人士、业内专家和其它专业人士，具备履行职务所必需的知识、技能和素质。

公司尊重并保障所有股东作为公司所有者的权利，按照《公司章程》《股东

会议事规则》等规定，严格规范股东会的召集、召开及表决程序，确保股东对法律、行政法规和《公司章程》规定的公司重大事项决策的参与，充分保障全体股东特别是中小股东的平等法律地位和合法权利。2026 年上半年，所有应由股东会审议的事项均严格履行审批权限与审议程序，不存在越权审批或先实施后审议的情形；共召开 1 次年度股东会及 1 次临时股东会，均由董事会召集召开，并聘请律师现场见证，会议程序合法合规。

公司持续夯实法人治理架构，健全内部控制制度，修订完善管理制度规范公司日常经营管理，持续推动董事会、股东会规范高效运作，充分发挥各治理主体作用，切实提升合规风险管控实效。

四、提升信息披露质效，加强价值传递

公司严格按照《公司信息披露管理办法》《公司投资者关系管理制度》等相关规定，指定董事会秘书负责公司的信息披露工作，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定媒体，确保公司所有股东能够平等地获取信息。公司已连续 3 年获深交所信息披露最高评级（A 级）。

2026 年上半年，公司以提升价值传递效能为导向，不断优化投资者关系管理体系。通过“互动易”平台、投资者邮箱、投资者专线、业绩说明会、券商策略会等多元沟通载体，及时回应市场关切，积极传递公司经营发展情况与长期投资价值，维护良好的投资者互动生态，致力于为全体股东创造长期价值。

五、以投资者为本，落实股东回报

为积极推进落实“质量回报双提升”行动方案，持续为股东创造长期投资价值，切实提升股东的获得感，公司延续稳健的现金分红政策，以持续稳定的现金分红回馈广大投资者：

报告期内，经公司第五届董事会第二十五次会议、2025 年度股东会审议通过，公司拟定 2025 年度利润分配预案：以截至 2026 年 3 月 28 日公司总股本 543,347,787 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金股利 271,673,893.50 元（含税）。本次利润分配方案已于 2026 年 5 月 8

日实施完毕。

面向未来中长期发展，扬杰科技将持续深耕功率半导体赛道，始终坚持技术创新攻坚，稳步加大研发资源投入，聚力推进技术迭代与产品升级，以高质量发展回馈社会。同时，公司将坚定不移贯彻以投资者为本的理念，持续完善公司治理、深化投资者交流、提升信息披露质效、扎实落实股东回报，持续夯实内在价值，切实履行上市公司责任，努力提升公司长期投资价值。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 22 日